



PAOLO PAVAN

Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
paolo.pavan@unimore.it

Professore Ordinario di Elettronica | *Senior Member IEEE (dal 2012)*

INCARICHI ATTUALI

- **Presidente**, Associazione Società Italiana di Elettronica (*Giugno 2024 – presente*)
- **Prorettore alle Relazioni Internazionali e Internazionalizzazione**, Università di Modena e Reggio Emilia (*2025 – presente*)
- **Professore Ordinario di Elettronica**, Università di Modena e Reggio Emilia (*2004 – presente*)
- **Associate Editor**, *IEEE Journal of the Electron Devices Society* (*Gennaio 2017 – presente*)

ISTRUZIONE E SOGGIORNI ACCADEMICI ALL'ESTERO

- **Visiting Scientist**, Saifun Semiconductors, Israele (*1997 – 2000*)
- **Visiting Graduate Student / Graduate Student**, University of California, Berkeley, USA (*1992 – 1994*)
- **Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica**, Università degli Studi di Padova (*1994*)
- **Laurea in Ingegneria Elettronica**, Università degli Studi di Padova (*1990*)

RUOLI ACCADEMICI E ISTITUZIONALI PREGRESSI

- **Delegato del Rettore per la Ricerca Scientifica dell'Ateneo** (*2019 – 2025*)
- **Presidente**, Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (*2018 – 2021*)
- **Presidente**, Consiglio Interclasse di Ingegneria Elettronica (*2008 – 2016*)
- **Membro**, Senato Accademico, Università di Modena e Reggio Emilia (*2010 – 2012*)
- **Presidente** (*2005 – 2011*) e **Cofondatore**, Consorzio Interuniversitario per la Nanoelettronica (IU.NET)
- **Professore Associato** (*1998 – 2004*) | **Ricercatore** (*1994 – 1998*)

ATTIVITÀ E PROGETTI DI RICERCA

Responsabile scientifico e coordinatore di progetti di ricerca nazionali, europei e industriali:

- **Dispositivi a Semiconduttore e Affidabilità**: Caratterizzazione, modellistica compatta e TCAD, analisi del degrado.
 - *Memorie non volatili e circuiti neuromorfici*: RRAM, applicazioni "logic-in-memory" e progettazione di circuiti neuromorfici.
 - *Dispositivi di potenza in GaN*: Ottimizzazione delle prestazioni e del ciclo di vita.
- **Elettronica Industriale ed Automotive**: Monitoraggio dei segnali fisiologici per l'identificazione dello stato di affaticamento del conducente.
- **Mobilità Internazionale**: Partecipante a programmi Erasmus+ KA107 (Vietnam e Brasile, 2018–2019).

PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE SCIENTIFICA

- Autore di **oltre 150 pubblicazioni** su riviste internazionali e atti di congressi internazionali e nazionali.
- Autore/coautore di **1 libro e 4 capitoli di libro**; contributore di diversi articoli ad invito.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E COMITATI INTERNAZIONALI

- **ESSDERC / ESSCIRC**: Advisor dello Steering Committee (2021), Membro dello Steering Committee (2015–2021), Technical Program Chair (2014), Membro del Comitato Tecnico (2012–2020).
- **IEEE IEDM**: Membro del Sottocomitato Tecnico (2020–2021, 2002–2003), European Arrangement Chair (2005–2006), Presidente del Sottocomitato Tecnico (2004).
- **ESREF**: Membro del Comitato Tecnico (2012–2020), Presidente del Comitato Tecnico sull'Affidabilità dei Dispositivi (2002).
- **IEEE IRPS**: Membro del Comitato Tecnico (2014–2015).
- **VLSI-TSA (Taiwan)**: Membro del Comitato Tecnico (2006–2010).
- **Ruoli Editoriali**: Guest Editor per *Solid-State Electronics* (2014); Editor dello Special Issue su Memorie Non Volatili per *IEEE TDMR* (Settembre 2004).